

# DTT61-s

## 液浸冷却用熱伝導シート

LiPOLY DTT61-s熱伝導シートは、液浸冷却 ( Immersion Cooling ) 環境向けに設計され、高出力AIチップの長時間稼働や冷却液内での使用に対応します。一般的な熱伝導材料に比べ、液浸冷却システム下で材料の状態と熱伝導性能を維持できるため、高熱負荷のAIサーバー環境に最適です。常温保管および輸送に対応し、液浸冷却アーキテクチャの各種用途にに適しています。

### ■ 製品の特性

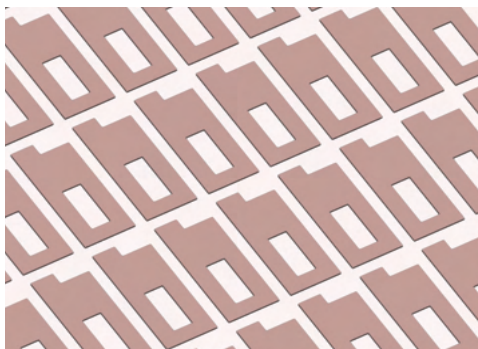
- / 熱伝導率: 6.0 W/m\*K
- / 液浸冷却用設計により冷却液との相性が良く、長時間の浸漬使用が可能
- / 高柔軟性により界面の隙間を効果的に充填し、製造公差を補正
- / 防水・高電気絶縁性により、システムの安全性を向上
- / 長時間稼働下でも材料の完全性と性能安定性を維持
- / 常温保管・輸送対応。高熱流束AIサーバーの長時間稼働環境に最適

### ■ 製品アプリケーション

- / AI GPUモジュールおよび自社開発ASIC ( NVIDIA / AMD )
- / AI液浸冷却サーバーおよび液冷
- / 混合型冷却システム
- / 高出力アクセラレータカードおよびHPC ( 高性能計算 ) システム
- / 産業用サーバーおよびエッジコンピューティングプラットフォーム
- / EV、グリーンエネルギー、高出力電子モジュール ( 電源、増幅器、5G通信等 )

### ■ 製品の形

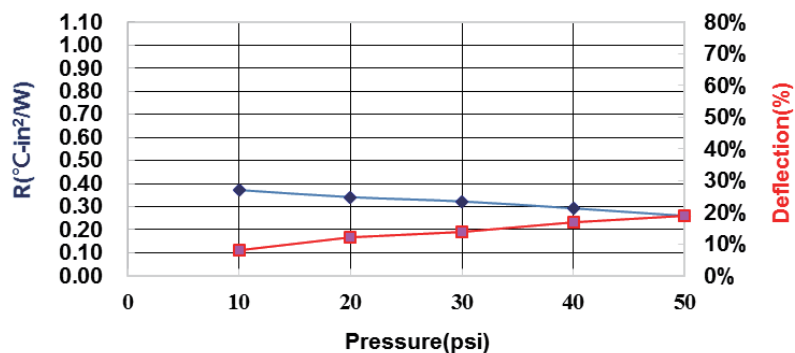
- / ロール状 / シート状
- / フォーミング形



### ■ 代表特性

物理特性	DTT61-s	試験方法	単位
色	Red	Visual	-
表面粘着性 ( 2面 / 1面 )	2	-	-
厚さ	Customized	ASTM D374	mm
密度	3.3	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>
使用温度	-60~200	-	°C
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率 @10 psi	4	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @20 psi	5	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @30 psi	8	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @40 psi	14	ASTM D5470 modify	%
圧縮率 @50 psi	19	ASTM D5470 modify	%
電気特性			
絶縁破壊電圧	8	ASTM D149	KV/mm
表面抵抗率	>10 <sup>11</sup>	ASTM D257	Ohm
体積抵抗率	>10 <sup>10</sup>	ASTM D257	Ohm-m
熱特性			
熱伝導率	6.0	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10psi	0.387	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@20psi	0.375	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@30psi	0.356	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@40psi	0.333	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W
熱抵抗@50psi	0.317	ASTM D5470	°C-in <sup>2</sup> / W

### 熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率



LiPOLY のすべての仕様は予告なしに変更されることがあります。LiPOLY は TIM テスター法および ASTM D5470 試験法を LiPOLY の定義として使用しています。購入者が要求した製品の特定の目的、性能、および品質は保証されません。購入者は、使用前にその安全性を評価および検証する必要があります。また、必要な特定の条件について事前に製品をテストし、期待される性能を検証する必要があります。製品の使用および適用に対する責任はエンドユーザーにあります。LiPOLY は、目的への適合性、商品性、または特定または一般的な目的のための材料または製品の非侵害の保証を否認します。LiPOLY は、偶発的または一般的な責任。すべての LiPOLY 製品は、その時点で有効な LiPOLY の販売条件に従って販売されるものとし、そのコピーは、コンプライアンスに基づいて提供されるものとします。LiPOLY、無断複写、転載を禁じます。LiPOLY の商標、および LiPOLY またはその関連会社を含むすべての権利は留保されています。他の製品またはサービス名は、第三者の所有物である可能性があります。この記事のいかなる内容も、LiPOLY またはその知的所有権に対する第三者へのライセンスを提供するものではありません。仮説または推奨事項は、特許が侵害されていないことを保証するものではありません。Copyright LiPOLY